

46-7451 Economy Version

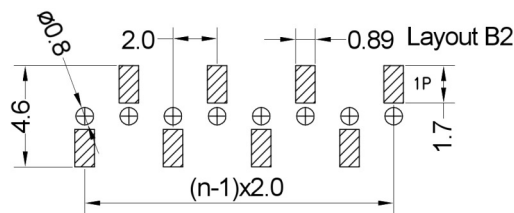
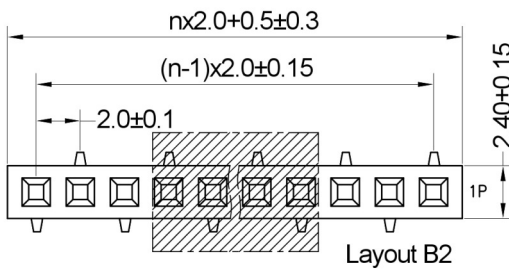
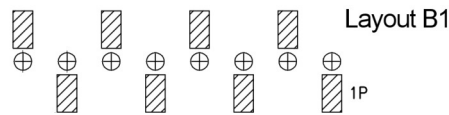
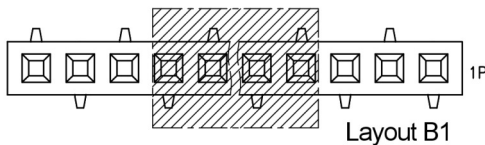
SMT-Buchsenleisten RM 2,00mm, stehend, 1-reihig – BH 4,3mm, durchsteckbar
SMT Female Headers, 2.00mm Pitch, Vertical, Single Row – 4.3mm Profile, Pass Through

Technische Daten / Technical Data

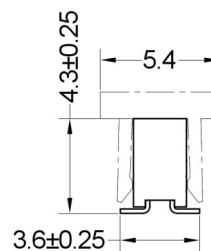
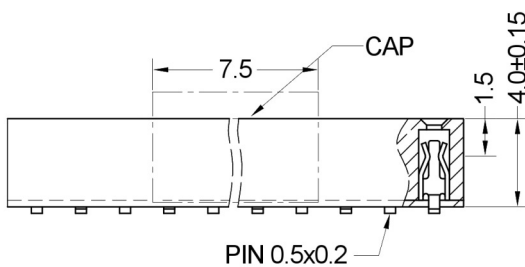
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Contact Material	Copper alloy
Kontaktoberfläche	Au über Ni
Contact Surface	Au over Ni
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	< 20 mΩ
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit	500 V AC/DC
Test Voltage	500 V AC/DC
Nennstrom	1,5 A
Current Rating	1.5 A
Temperaturbereich	-40 °C ... +105 °C
Temperature Range	-40 °C ... +105 °C
Verarbeitung	230 °C für 30-60 Sekunden (260 °C für 10 Sekunden)
Processing	230 °C for 30-60 seconds (260 °C for 10 seconds)



Doppelfederkontakte für Vierkantstifte 0,50mm.
Dual beam contacts accept 0.50mm square pins.



Recommended PCB Layouts (Top Side)
(PCB BOARD TOLERANCE ±0.05)



Series

46-7451

Contacts*

030

004-030 Einreihig
Single row

Layout*

1

1 Layout B1
2 Layout B2

Type

20

20 H=4.3 C=3.6mm

Plating

00

00 Vergoldet
Gold plated

Packaging*

ST

ST
PPST
PPTR

Lieferformen / Packaging Options:

ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads
PPST In Stangen mit Pick&Place-Pads / In tubes with Pick&Place-Pads
PPTR Tape & Reel mit Pick&Place-Pads / Tape & Reel with Pick&Place-Pads

* Dies ist ein Bestellbeispiel - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* This is an order example - please replace by your specifications.

Reflow-Lötverfahren

Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	untere Temperaturangabe [°C]
Verweildauer oberhalb T_L	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	obere Temperaturangabe [°C]
Dauer Höchsttemperatur	laut Angabe im Datenblatt [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	Lower Temperature [°C]
Duration above T_L	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	Upper Temperature [°C]
Duration Peak Temperature	Acc. to datasheet [sec]
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

